

PCT

ORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ :

H01L 21/00, C25D 7/12

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/55888

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

21. September 2000 (21.09.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/01984

(22) Internationales Anmeldedatum:

8. März 2000 (08.03.00)

(30) Prioritätsdaten:

199 11 084.0

12. März 1999 (12.03.99)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): STEAG
MICROTECH GMBH [DE/DE]; Carl-Benz-Strasse 10,
D-72124 Pliezhausen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KROEBER, Wolfgang
[DE/DE]; Gartenstrasse 6, D-78166 Donaueschingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, SG, US, europäisches Patent
(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen
eintreffen.

(54) Title: DEVICE FOR TREATING SUBSTRATES

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM BEHANDELN VON SUBSTRATEN

(57) Abstract

The invention relates to a device for treating substrates, especially semiconductor wafers, with at least one processing container that is provided with an opening which can be closed from the exterior during the treatment with the substrate. The aim of the invention is to provide a simple and homogeneous treatment of a surface pertaining to a substrate. The aim of the invention is also to reduce the danger of damage between successive treatment steps. To this end, a second processing container is provided adjacent to the first processing container. The wall of said second processing container is at least partially the container wall of the first processing container, whereby said container wall is provided with the opening which can be closed from the side of the first processing container.

(57) Zusammenfassung

Bei einer Vorrichtung zum Behandeln von Substraten, insbesondere Halbleiterwafern, mit wenigstens einem eine Öffnung aufweisenden Prozeßbehälter, wobei die Öffnung während der Behandlung durch das Substrat von außen schließbar ist, wird eine einfache und homogene Behandlung einer zu behandelnden Oberfläche des Substrats und eine Verringerung der Gefahr einer Beschädigung zwischen aufeinanderfolgenden Behandlungsschritten dadurch erreicht, daß benachbart zum ersten Prozeßbehälter ein zweiter Prozeßbehälter vorgesehen ist, dessen eine Wand zumindest teilweise die die Öffnung enthaltende Behälterwand des ersten Prozeßbehälters ist und die Öffnung von der Seite des ersten Prozeßbehälters her schließbar ist.

